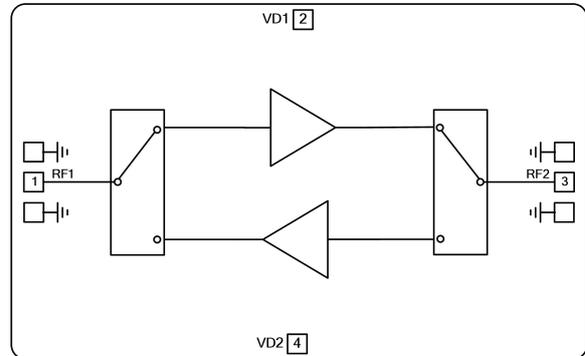




主要特点

- 工作频率: 0.8 - 20 GHz
- 噪声系数: 3.0 dB
- 增益: 15 dB
- P1dB: +16 dBm
- 自偏置供电: +5 V @ 46mA
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 2.0 × 2.0 × 0.1 mm<sup>3</sup>

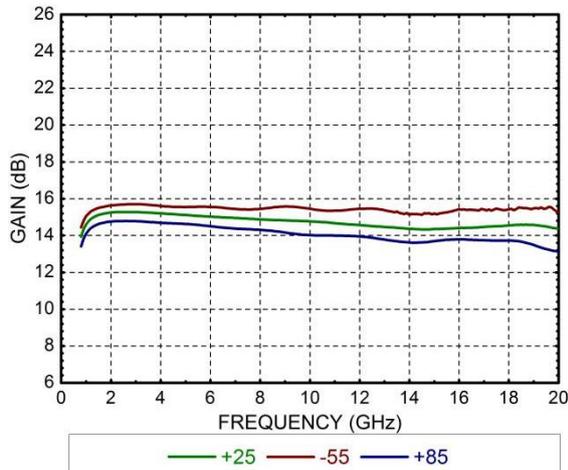
功能框图



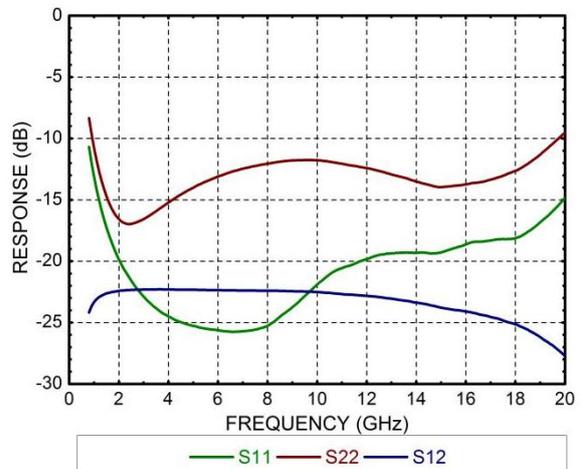
性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ ,  $VD = +5\text{ V}$ ,  $IDD = 46\text{ mA}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	0.8-20			GHz
增益		15		dB
增益平坦度		±0.5		dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		13		dB
输出功率 1dB 压缩点		16		dBm
饱和输出功率		17		dBm
输出 IP3		25		dBm
噪声系数		3		dB
工作电流	35	46	60	mA

增益

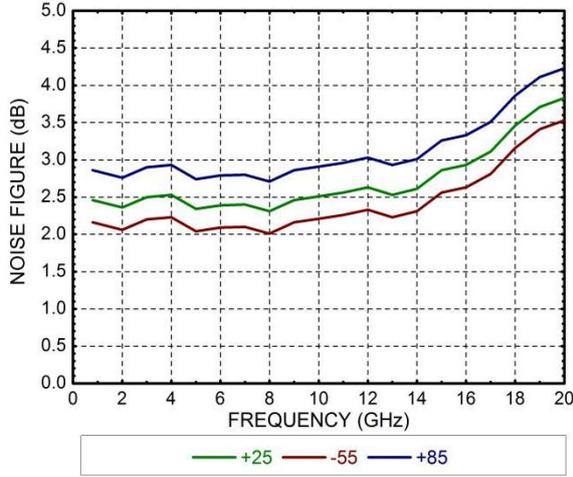


回波损耗&反向隔离

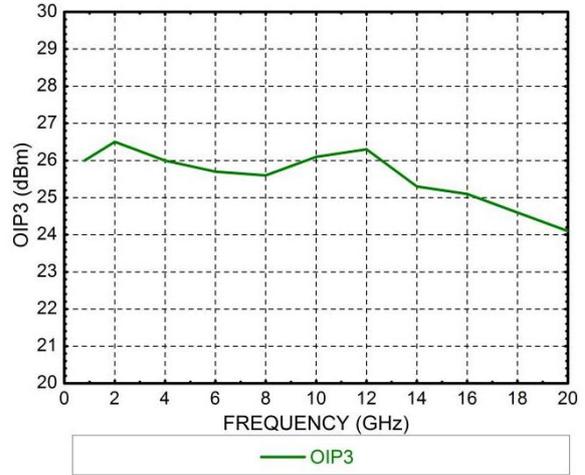




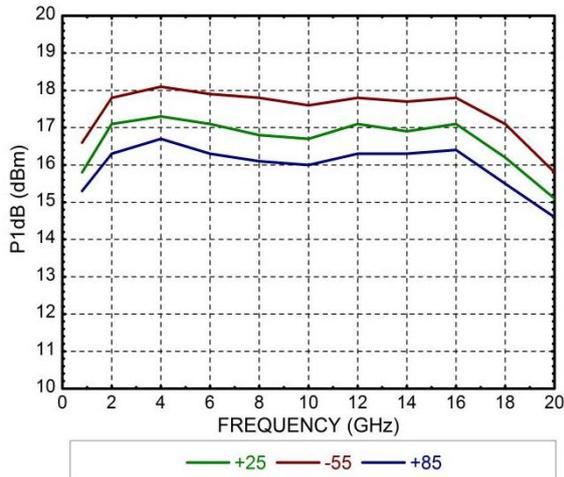
### 噪声系数



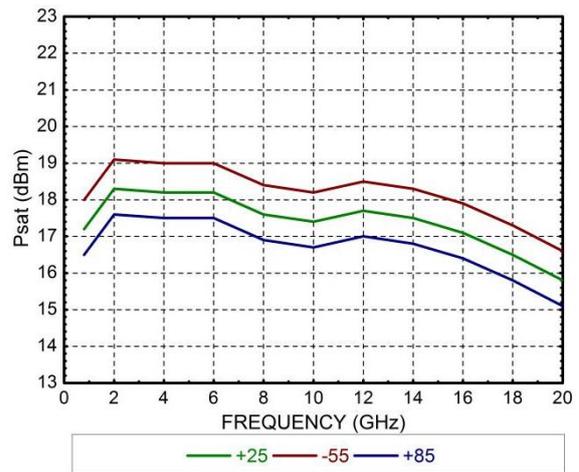
### OIP3



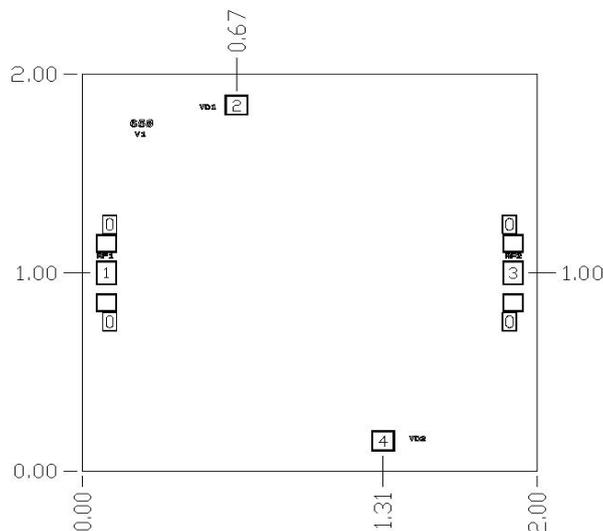
### 输出功率 $P_{-1}$



### 输出功率 $P_{sat}$



### 物理参数





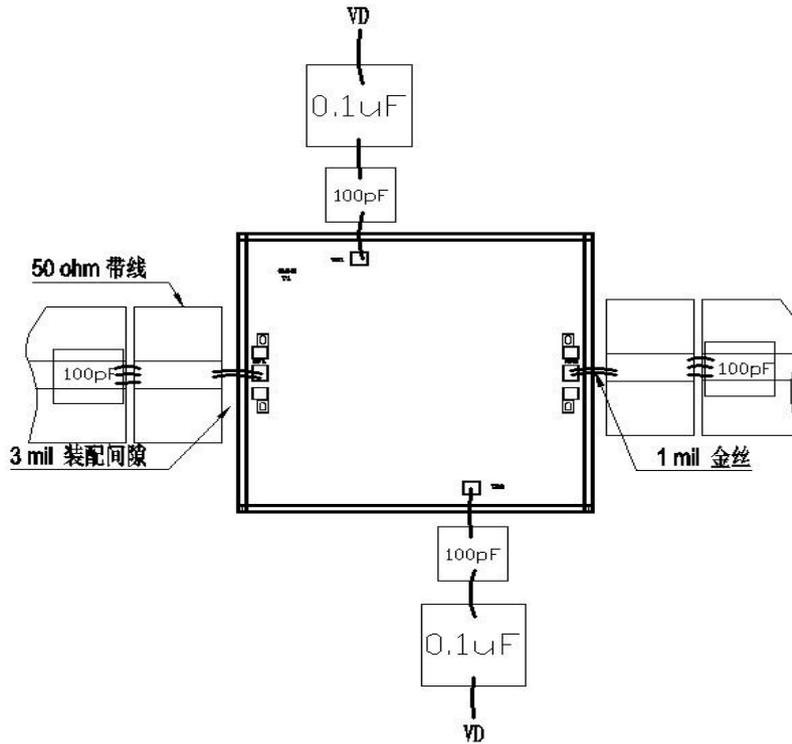
焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 3	RF1, RF2	该焊盘是射频输入输出端口, 需要外接 100pF 隔直电容
2	VD1	该焊盘提供 RF1-RF2 放大器的电源电压
4	VD2	该焊盘提供 RF2-RF1 放大器的电源电压
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

真值表

功能	VD1	VD2
RF1-RF2	+5V	接地或悬空
RF2-RF1	接地或悬空	+5V

装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100  $\mu\text{m}$
2. 典型键合焊盘尺寸为  $120 \times 90 \mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 电源电压: +6 V
2. 射频输入功率: +18 dBm
3. 储存温度:  $-65 \sim +150 \text{ }^\circ\text{C}$
4. 工作温度:  $-55 \sim +85 \text{ }^\circ\text{C}$